

未来COLLEGE

半導体業界インターンシップ オンライン合同説明会2021

6月19日(土)27日(日) 10:00~17:00

本イベントは、グローバルで活躍する半導体関連企業の会社説明やインターンシッププログラムの説明がオンラインで聞けるイベントです。ぜひ半導体の世界を覗きにきてください。

主催  SEMIは半導体製造関連業界唯一のグローバル団体です。

参加企業

 Asahi Diamond Industrial Co., Ltd.

 APPLIED MATERIALS

 EBARA

 KOKUSAI ELECTRIC

 SCREEN

 SONY
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社

 DAIFUKU

 TEL

 ACCRETECH
東京精密

 NISSIN
ION EQUIPMENT

 TEXAS
INSTRUMENTS

 MJC

 Fujikin

 Micron

 muratec

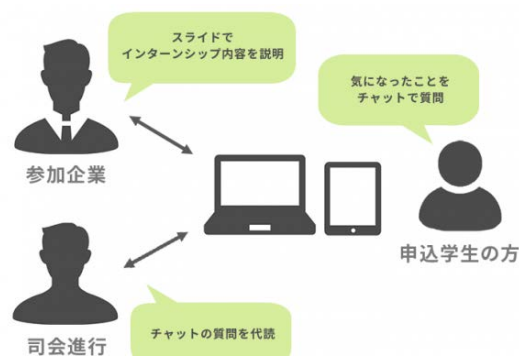
実施内容

1グループ3~4社、各グループとも下記の流れで進行

- ① 本日の全体の流れについて
- ② 会社概要・インターンシップ説明 (各社20分)
- ③ チャットにて質疑応答 (各社5分)



Microsoft Teamsを用いて実施します。



申込方法

右記のQRコードにアクセスし、参加を希望されるグループにお申込み下さい。
※各企業のインターンシップの内容も随時更新しておりますので、申し込む際にご覧ください。



<http://www1.semi.org/jp/Internship>